

L-6524T600C2

(両面板)

W - Sided Copper Clad Laminates

L-6524T600C1

(片面板)

S - Sided Copper Clad Laminates

ガラス布・ガラス不織布基材エポキシ樹脂銅張積層板(CEM-3) Glass fabric, glass non-woven fabric base epoxy resin copper-clad laminates (CEM-3)

■特長 Characteristic

- 耐トラッキング性に優れています (CTI 600V以上)。 Tracking resistance is excellent (CTI ≥600V).
- 放熱性に優れています(熱伝導率 0.9 W/(m · K))。 Heat dissipation is excellent. Thermal conductivity 0.9 W/(m · K).
- パンチング加工が可能です。 Punching work is available.

[UV遮蔽タイプ : L-6524T600C2 UV]

W - sided Copper Clad Laminates of UV shielding type:L-6524T600C2 UV

■用途 Use applications

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| ●電源機器 | For power equipment |
| ●屋外設置機器 | For equipment of outdoor installation |
| ●家電 | For home appliance |
| ●アミューズメント機器 | For amusement components |
| ●LED照明機器、他 | For LED lighting equipment, others |

■仕様 Specification

●両面板、片面板 Copper clad laminates

| 品番 Products | 定尺寸法 (縦×横) Standard size (Lw × Cw) | 銅箔厚さ Copper foil thickness | 公称板厚 Nominal thickness | 厚さ許容差 Thickness tolerance | |
|----------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | 両面板、片面板 W / S - sided CCL | W / S - sided CCL |
| L-6524T600C2 | 1,020 ⁺¹⁰ ₋₀ × 1,020 ⁺¹⁰ ₋₀ mm | 18 μm | 0.8mm | ±0.17 | |
| L-6524T600C1 | 1,020 ⁺¹⁰ ₋₀ × 1,220 ⁺¹⁰ ₋₀ mm | 35 μm | 1.0mm | ±0.18 | |
| | | 70 μm | 1.2mm | ±0.19 | |
| | | | 1.6mm | ±0.19 | |

■一般特性例 Properties

| 試験項目 Item | | 処理条件 Treatment | 単位 Unit | 実測値 Actual value |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ガラス転移温度(Tg) Glass transition temp | TMA | 昇温:10°C/min Heating rate:10°C/min | °C | 130 |
| | DSC | 昇温:20°C/min Heating rate:20°C/min | °C | 130 |
| 熱膨張係数 Coefficient of thermal expansion | X(横) α1 | TMA | ppm/°C | 18 |
| | Y(縦) α1 | | ppm/°C | 20 |
| | Z α1 | | ppm/°C | 50 |
| | α2 | | ppm/°C | 300 |
| 熱分解温度(Td) Decomposition temp | TG/DTA法(5%重量減少) (5% weight loss) | 昇温:20°C/min Heating rate:20°C/min | °C | 380 |
| 熱伝導率 Thermal conductivity | LF法 Laser flash method | A | W/(m · K) | 0.9 |
| 比熱容量 Specific heat capacity | LF法 Laser flash method | A | J/(g · K) | 1.2 |
| はんだ耐熱性 260°C | はんだ耐熱性 260°C Solder heat resistance at 260°C | A | 秒 sec. | ≥120 |
| T ₂₈₈ Time to delamination | TMA | TMA | 分 min | 25 |
| 銅箔引き剥がし強さ Peel strength | 18 μm | N/mm | 1.4 | |
| | S ₄ | | 1.4 | |
| | 35 μm | | 1.8 | |
| | S ₄ | | 1.8 | |
| 曲げ強さ Flexural strength | 縦 Lw / 横 Cw | A | MPa | 365 / 275 |
| 曲げ弾性率 Flexural modulus | 縦 Lw / 横 Cw | A | GPa | 17 / 13 |
| 比誘電率 Dielectric constant (Dk) | 1MHz | C-96/20/65 | — | 4.8 |
| | 1GHz | | — | 4.3 |
| 誘電正接 Dissipation factor (Df) | 1MHz | C-96/20/65 | — | 0.021 |
| | 1GHz | | — | 0.021 |
| 体積抵抗率 Volume resistivity | C-96/20/65 | MΩ · m | 1 × 10 ⁸ | |
| 表面抵抗 Surface resistance | C-96/20/65 | MΩ | 1 × 10 ⁹ | |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | C-96/20/65 | MΩ | 1 × 10 ⁹ | |
| 比較トラッキング指数 (CTI値) Comparative tracking index (CTI) | A | V | ≥600 | |
| 吸水率 Water absorption | E-24/50 + D-24/23 | % | 0.04 | |
| 耐アルカリ性 (3%NaOH溶液) Alkali resistance(3% NaOH aq) | 40°C/3min 浸漬 Dip | — | 異常なし No remarkable change | |
| UV透過率(UV遮蔽タイプ) UV transmittance of UV shieldeing type | UV-35 | A | % | 0.02 |
| | UV-42 | A | % | 1.81 |
| 耐燃性 UL94 Flammability UL94 | E-24/125 | — | 94V-0 | |

* 1 上記試験はJIS C 6481、IPC TM650、IEC-60112、UL規格に準じます。

*1 The above tests are in accordance with JIS C6481, IPC TM650, IEC-60112, and UL.

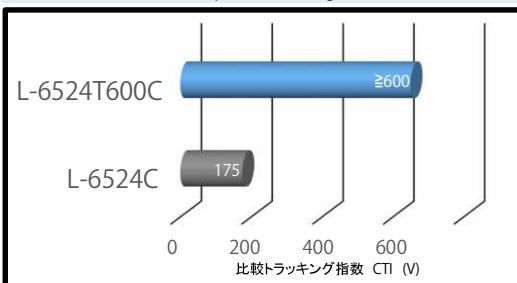
* 2 試験板厚は1.6mmです。

* 3 上記は実測値であり、保証値ではございません。

*2 The sample thickness is 1.6mm.

*3 The above data is actual values and not guaranteed values.

■耐トラッキング性 Comparative tracking index (CTI)



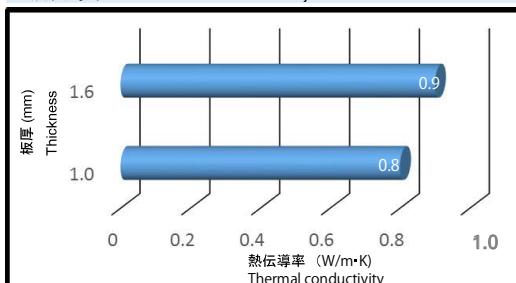
○測定方法:IEC-60112準拠

Measuring method : Conform to IEC-60112

○板厚:1.6mm

Thickness

■熱伝導率 Thermal conductivity



○測定方法:レーザーフラッシュ法

Measuring method : Laser flash method